

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年7月3日(03.07.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/141970 A1

(51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/031767

(22) 国際出願日: 2024年9月4日(04.09.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-219832 2023年12月26日(26.12.2023) JP
特願 2024-102297 2024年6月25日(25.06.2024) JP

(71) 出願人: J X 金属株式会社 (JX ADVANCED METALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1058417 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 (JP).

(72) 発明者: 遠藤 瑶輔 (ENDO, Yosuke); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4

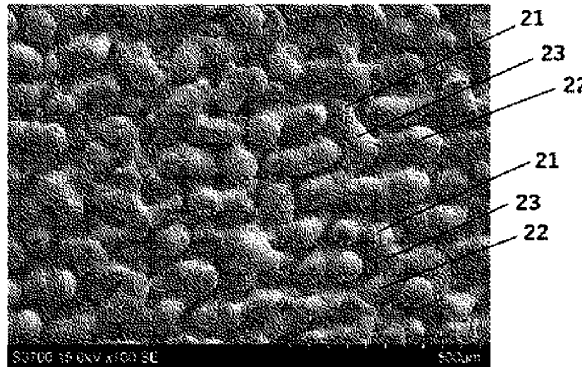
J X 金属株式会社磯原工場内 (JP). 杉本圭次郎 (SUGIMOTO, Keiji); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 (JP). 岩淵 靖幸 (IWABUCHI, Yasuyuki); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 (JP). 本田 和也 (HONDA, Kazuya); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 (JP).

(74) 代理人: アクシス国際弁理士法人 (AXIS PATENT INTERNATIONAL); 〒1050004 東京都港区新橋二丁目6番2号新橋アイマークビル (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,

(54) Title: SPUTTERING TARGET FOR MAGNETIC MATERIAL, SPUTTERING TARGET ASSEMBLY FOR MAGNETIC MATERIAL, AND METHOD FOR MANUFACTURING SPUTTERING TARGET FOR MAGNETIC MATERIAL

(54) 発明の名称: 磁性材料用スパッタリングターゲット、磁性材料用スパッタリングターゲット組立品及び磁性材料用スパッタリングターゲットの製造方法



(57) Abstract: Provided are a sputtering target for a magnetic material in which redeposition film peeling can be effectively suppressed, a sputtering target assembly for a magnetic material, and a method for manufacturing a sputtering target for a magnetic material. Provided is a sputtering target for a magnetic material, the sputtering target having a sputtering region and a non-sputtering region, wherein the surface of the non-sputtering region has a plurality of rounded protrusions, and the plurality of protrusions include protrusions connected via a connection part and/or protrusions not connected via a connection part.

(57) 要約: リデポ膜剥離を良好に抑制することが可能な磁性材料用スパッタリングターゲット、磁性材料用スパッタリングターゲット組立品及び磁性材料用スパッタリングターゲットの製造方法を提供する。スパッタ領域と非スパッタ領域とを有し、磁性材料用であるスパッタリングターゲットであって、非スパッタ領域の表面は、丸みを帯びた複数の凸部を有し、複数の凸部は、連結部を介して連結されている凸部、及び/または、連結部を介して連結されていない凸部を含む、磁性材料用スパッタリングターゲット。

[続葉有]

WO 2025/141970 A1

EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))